

中国芯片设计产业竞争调研及未来五年发展机遇 研究报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国芯片设计产业竞争调研及未来五年发展商机研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/ruanjian/212865212865.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

报告大纲

第一章 全球芯片设计行业运行状况探析

第一节 全球芯片设计行业基本特点

一、市场繁荣带动产业加速发展

二、企业重组呈现强强联合趋势

第二节 全球芯片设计行业结构分析

一、全球芯片设计行业产业规模

二、全球芯片设计行业产业结构

第三节 全球主要国家和地区发展分析

一、美国芯片设计行业发展分析

二、日本芯片设计行业发展分析

三、台湾芯片设计行业发展分析

四、印度芯片设计行业发展分析

第四节 未来五年全球芯片设计业趋势探析

第二章 世界典型芯片设计企业运行分析

第一节 高通 (QUALCOMM)

一、企业概况

二、经营动态分析

三、企业竞争力分析

四、未来发展战略分析

第二节 博通 (BROADCOM)

一、企业概况

二、经营动态分析

三、企业竞争力分析

四、未来发展战略分析

第三节 NVIDIA

一、企业概况

二、经营动态分析

三、企业竞争力分析

四、未来发展战略分析

第四节 新帝 (SANDISK)

一、企业概况

二、经营动态分析

三、企业竞争力分析

四、未来发展战略分析

第五节 AMD

一、企业概况

二、经营动态分析

三、企业竞争力分析

四、未来发展战略分析

第三章 中国芯片设计行业运行环境解析

第一节 中国宏观经济环境分析

一、中国GDP分析

二、中国工业发展形势

三、消费价格指数分析

四、城乡居民收入分析

五、社会消费品零售总额

六、全社会固定资产投资分析

七、进出口总额及增长率分析

四、存贷款利率变化

五、财政收支状况

第二节 中国芯片设计行业政策法规环境分析

一、国货复进口政策

二、政府优先发展IC设计业政策

三、各地IC设计产业优惠政策

四、数字电视战略推进表

五、外汇管理体制的缺陷

第三节 中国芯片设计行业技术发展环境分析

一、芯片工艺流程

二、低功率芯片技术可能影响整个芯片设计流程

三、我国技术创新与知识产权

四、我国芯片设计技术最新进展

第四章 我国芯片设计行业运行新形势透析

第一节 中国芯片设计行业运行总况

一、行业规模不断扩大

二、行业质量稳步提高

三、产品结构极大丰富

四、原材料与生产设备配套问题

第二节中国芯片设计运行动态分析

- 一、产业持续快速发展，但增速呈逐年放缓趋势
- 二、中国自主标准为国内设计企业带来发展机遇
- 三、模拟IC和电源管理芯片成为国内IC设计热门产品

第三节中国芯片设计行业经济运行分析

- 一、行业经济指标运行
- 二、芯片设计业进出口贸易现状
- 三、行业盈利能力与成长性分析

第四节中国芯片设计行业发展中存在的问题

- 一、企业规模问题分析
- 二、产业链问题分析
- 三、资金问题分析
- 四、人才问题分析
- 五、发展的建议与措施

第五章中国芯片设计市场运行动态分析

第一节中国芯片设计市场发展分析

- 一、中国芯片设计市场消费规模分析
- 二、主要行业对芯片的需求统计分析

第二节中国芯片制造市场生产状况分析

- 一、芯片的产量分析
- 二、芯片的产能分析
- 三、产品生产结构分析

第三节中国芯片设计产业发展地区比较

第六章中国芯片设计产品细分市场运行态势分析

第一节中国芯片细分市场发展局势分析

- 一、生物芯片
- 二、通信芯片
- 三、显示芯片
- 四、数字电视芯片
- 五、标签芯片

第二节电子芯片市场分析

第三节通讯芯片市场分析

第四节汽车芯片市场分析

第五节手机芯片市场分析

第六节电视芯片市场分析

第七章 中国芯片设计业竞争产业竞争态势分析

第一节 中国芯片设计业竞争格局分析

- 一、国际芯片设计行业的竞争状况
- 二、我国芯片设计业的国际竞争力
- 三、外资企业进入国内市场的影响
- 四、IC设计企业面临的挑战分析

第二节 中国我国芯片设计业的竞争现状综述

- 一、我国芯片设计企业间竞争状况
- 二、潜在进入者的竞争威胁
- 三、供应商与客户议价能力

第三节 中国芯片设计业集中度分析

- 一、区域集中度分析
- 二、市场集中度分析

第四节 中国芯片设计业提升竞争力策略分析

第八章 中国芯片设计行业内优势企业财务分析

第一节 大唐微电子技术有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第二节 大连路美芯片科技有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第三节 上海华虹NEC电子有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第四节 上海蓝光科技有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第五节 福州瑞芯微电子有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第六节 有研半导体材料股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第七节 大连路美芯片科技有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第九章 中国芯片设计相关产业运行分析

第一节 IC制造业

第二节 IC封装测试业

第三节 IC材料和设备行业

第四节 上游原材料

第十章 未来五年中国芯片设计行业前景预测与趋势分析

第一节 未来五年中国芯片业前景领域展望

- 一、节能芯片前景展望
- 二、电视芯片前景预测分析
- 三、手机多媒体芯片市场前景研究
- 四、TD芯片前景好转

第二节 未来五年中国芯片设计市场发展预测

- 一、中国芯片设计市场规模预测
- 二、细分市场规模预测
- 三、产业结构预测
- 四、销售模式：由提供芯片向提供整体解决方案转变

第十一章 未来五年中国芯片设计行业投资战略分析

第一节 未来五年中国芯片设计行业投资概况

- 一、芯片设计行业投资特性
- 二、芯片设计行业投资环境分析

第二节 未来五年中国芯片设计行业投资机会分析

- 一、台湾放行四家芯片商投资大陆
- 二、半导体芯片产业或成投资热点
- 三、应用芯片研究前景广阔
- 四、生物芯片投资时刻到来

第三节 未来五年中国芯片设计行业投资风险预警

- 一、市场竞争风险
- 二、政策性风险
- 三、技术风险
- 四、进入退出风险

图表详见正文•••••

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/ruanjian/212865212865.html>